

江苏综艺股份有限公司 关于上海证券交易所《关于对江苏综艺股份有限公司重大 资产购买预案的问询函》的回复公告

江苏综艺股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“综艺股份”）于 2025 年 6 月 25 日收到上海证券交易所《关于对江苏综艺股份有限公司重大资产购买预案的问询函》（上证公函【2025】0923 号，以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的相关要求，公司组织相关各方对有关问题进行了认真分析和研究，并逐项予以落实和回复。公司根据《问询函》的回复内容对《江苏综艺股份有限公司重大资产购买预案》及其摘要进行了补充披露，并以楷体加粗标明。因公司目前尚未最终完成独立财务顾问、评估师的聘任程序，本次回复不包含独立财务顾问、评估师的核查意见。本问询函回复中涉及的标的公司财务数据未经审计。

如无特别说明，本回复中的简称与名词的释义与《江苏综艺股份有限公司重大资产购买预案》相同。现就相关问题作以下回复说明：

重要内容提示：

《问询函》回复内容中涉及标的公司业绩承诺期内收入、毛利率、净利润等测算系标的公司管理层基于对行业和标的公司经营情况预估，本次交易涉及的业绩承诺的合理性和可实现性仍需进一步论证，待标的公司审计、评估工作完成后，上市公司将在重组报告书中对标的公司业绩承诺等重要事项进行审慎论证并及时披露，提请投资者注意相关投资风险。

1、关于交易目的与标的公司业务

预案显示，吉莱微主营功率半导体芯片及器件的研发、生产和销售，采用以 IDM 模式为主、Fabless 模式为辅的经营模式，目前拥有 4 英寸、5 英寸和在建的 6 英寸晶圆生产线，配套兼容 4 英寸、5 英寸、6 英寸和 8 英寸的芯片封装测试生产线。前期公告显示，上市公司现有芯片设计及应用业务以助听器芯片和智能卡为主。

请公司补充披露：（1）标的公司所处细分行业的基本情况，包括但不限于细分市场规 模、主要应用领域、竞争格局等，结合同行业可比公司情况，分析说明标的公司所处的行业地位和相较于主要竞争对手的经营优劣势；（2）结合上市 公司的主业经营情况、发展战略，说明本次交易与上市公司主业的协同性，是 否有助于提高上市公司资产质量。请独立财务顾问发表意见。

【回复】

一、标的公司所处细分行业的基本情况，包括但不限于细分市场规 模、主要 应用领域、竞争格局等，结合同行业可比公司情况，分析说明标的公司所处的行 业地位和相较于主要竞争对手的经营优劣势

（一）标的公司所处细分行业的基本情况，包括但不限于细分市场规 模、主 要应用领域、竞争格局等

1、标的公司所处行业概述

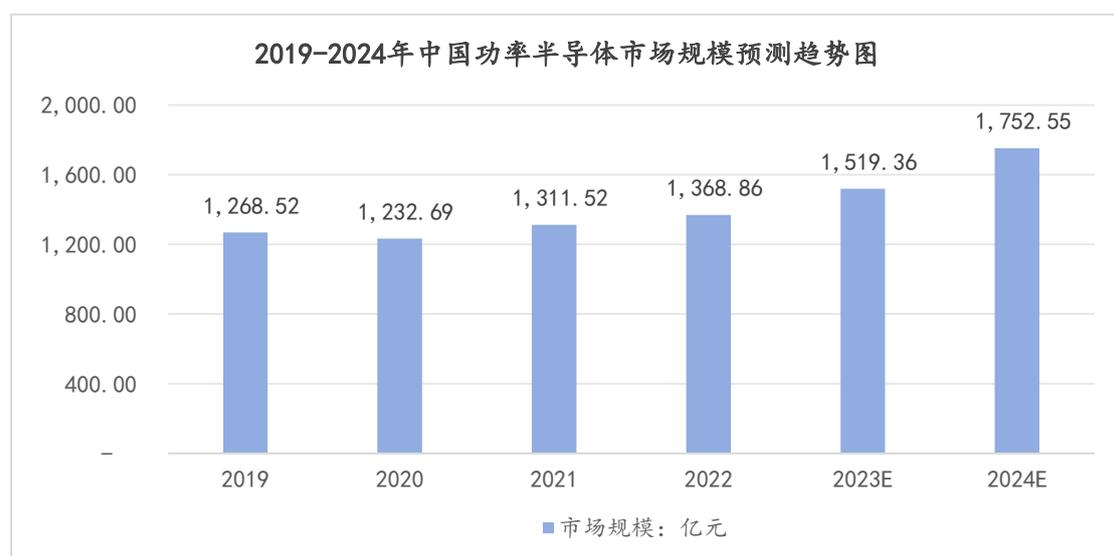
标的公司专业从事功率半导体芯片及器件的研发、生产和销售，是一家以芯 片设计、晶圆制造、封装测试的垂直一体化经营为主的功率半导体芯片及器件制 造企业。功率半导体是电子装置中电能转换与电路控制的核心，主要用于改变电 子装置中电压和频率、直流交流转换，可通过半导体的单向导电性实现电源开关 和电力转换的功能。

根据《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），标的公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”下属的“C3972 半导体分立器件制造”细 分行业。细分行业的具体分类及产品类别如下图所示：

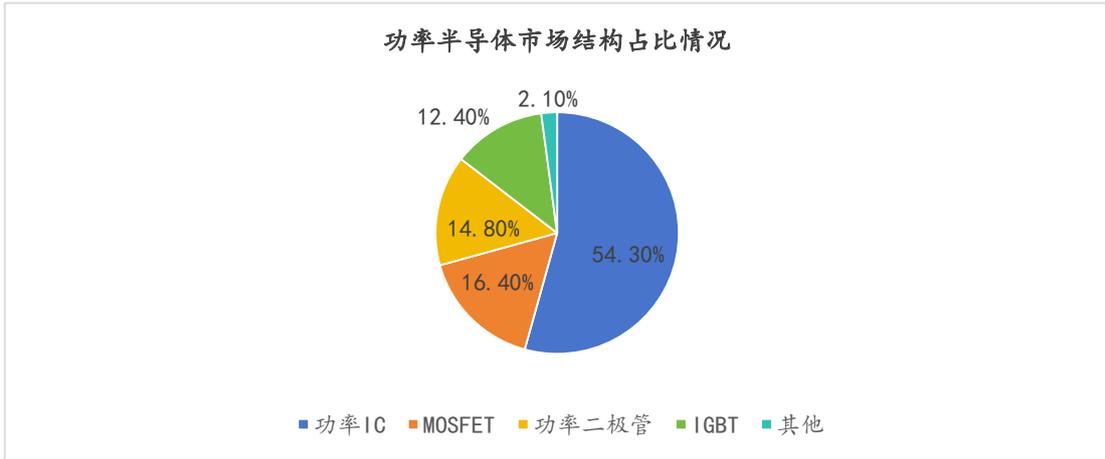


2、标的公司所处行业的市场规模

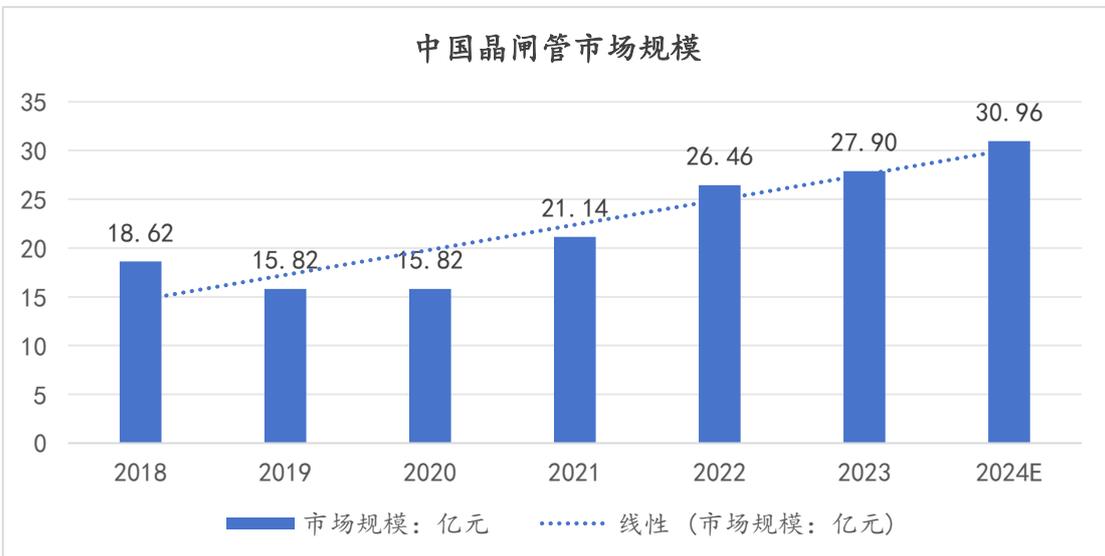
根据中商产业研究院发布的《2024-2029 年中国功率半导体产业市场供需格局及发展前景预测报告》，2023 年中国功率半导体市场规模约 1,519.36 亿元，2024 年预计将达 1,752.55 亿元，2019 年至 2024 年的年均复合增长率预计为 6.68%。功率半导体市场涵盖功率 IC（集成电路）和功率半导体器件，其中，功率半导体器件的占比约为 45.7%，对应的 2024 年预计市场规模为 800.92 亿元。



在功率半导体市场中，MOSFET、二极管、IGBT 占比分别为 16.4%、14.8%、12.4%，对应的 2024 年预计市场规模分别为 287.42 亿元、259.38 亿元、217.32 亿元。



功率半导体器件细分领域中，除 MOSFET、二极管、IGBT 等占比较高的品类外，还包括晶闸管等其他品类。晶闸管作为一种基础型功率半导体分立器件，主要用于电力变换与控制，可以用微小的信号功率对大功率的电流进行控制和变换。晶闸管根据性能分类主要包括单向晶闸管、双向晶闸管、光控晶闸管、逆导晶闸管、可关断晶闸管、快速晶闸管、高频晶闸管等。晶闸管作为一种技术相对成熟的产品，其市场成长性趋于稳定。根据观知海内咨询统计数据，2024 年中国晶闸管市场规模预计将达到 30.96 亿元，具体如下：

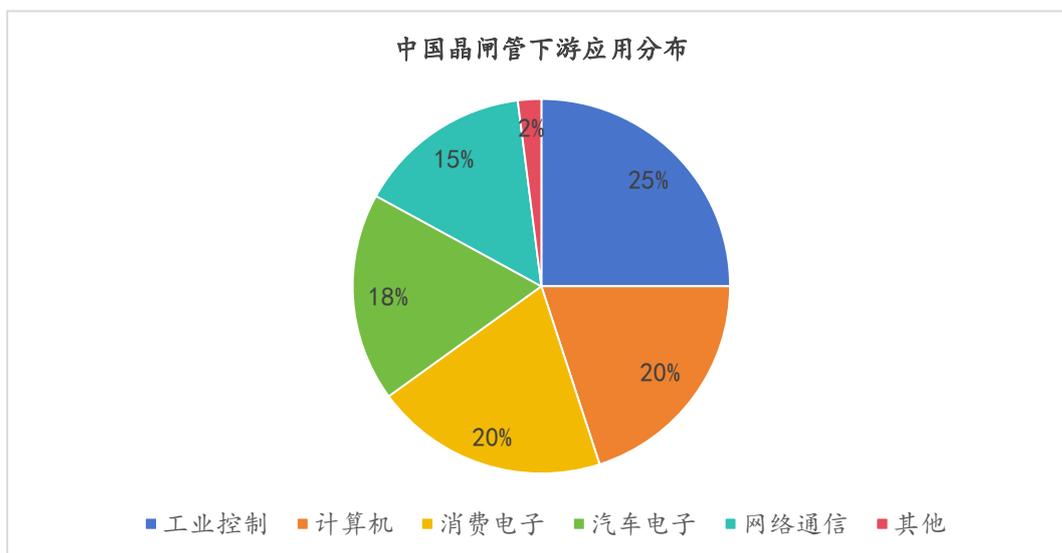


如上表所示，根据观知海内咨询统计数据，晶闸管市场规模近年来呈稳定增长趋势，最近五年年均复合增长率为 14.37%。

3、标的公司所处行业的主要应用领域

标的公司当前产品以晶闸管和保护器件为主。其中，晶闸管具有制造成本低、可靠性高、相应配套电路结构简单、体积小和重量轻等特点，具备突出的性价比优势，因此广泛应用于工业控制、计算机、消费电子、汽车电子等多个领域。

根据观知海内咨询统计数据，中国晶闸管下游应用分布情况具体如下：

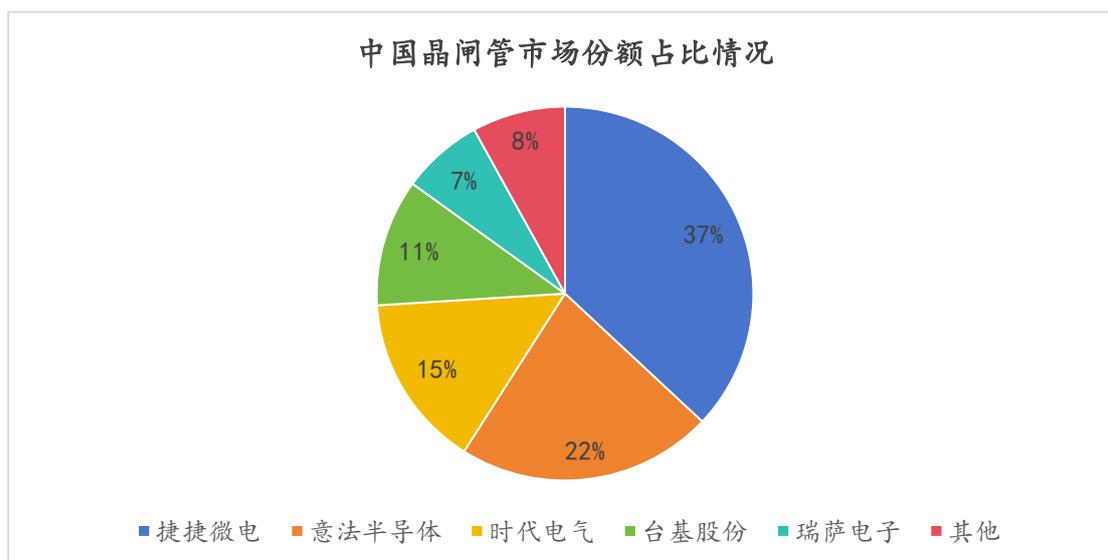


保护器件属于二极管，其种类较多，主要包括浪涌电流抑制器（TSS）、瞬态电压抑制器（TVS）、静电保护器件（ESD）、集成保护器件、压敏电阻等，标的公司保护器件产品主要包括ESD、TVS、TSS等。由于包括保护器件在内的二极管等功率器件具有通用性、灵活性，以及集成电路不具备的部分特殊功能，因此在下游领域有着不可替代的关键作用。

保护器件产品可广泛应用于汽车电子系统、楼宇监控及安防系统、通讯设备及通讯终端、电脑各种接口保护、电子消费品、便携式电子产品、仪器仪表、家用电器和工业电器控制等各类需要防浪涌冲击、防静电的电子产品内部，用以对电路提供保护，以免受到突发的过高电压或过大电流损害。例如，由于集成电路追求小型化、功能集成化，要求设计线宽越来越小，导致芯片本身对静电、浪涌等外部干扰极其敏感，需要TVS作为额外保护；ESD保护器件通常具有响应时间短、具备静电防护和浪涌吸收能力强等优点，可用于保护设备电路免受各类静电及浪涌的损伤。

4、标的公司所处行业的竞争格局

标的公司当前产品以晶闸管和保护器件为主，在晶闸管竞争格局方面，国内厂商以江苏捷捷微电子股份有限公司（简称“捷捷微电”）、株洲中车时代电气股份有限公司（简称“时代电气”）、湖北台基半导体股份有限公司（简称“台基股份”）、标的公司为主，国际厂商主要为意法半导体、瑞萨电子等。根据观知海内咨询统计数据，捷捷微电的市场占有率约 37.0%，其次为意法半导体、时代电气等，具体如下：



在晶闸管细分市场方面，国内企业的竞争优势较好，以捷捷微电为首的国内企业占据着较高的市场份额；同时晶闸管细分市场的整体市场规模呈上升趋势，行业发展前景良好。

在保护器件方面，中国作为全球电路保护元器件主要生产基地之一，行业内企业主要分布在珠三角、长三角、京津冀等区域。深圳、上海、苏州、杭州、北京等地集中了大量的电路保护元器件制造商和供应链企业，主要厂商包括扬州扬杰电子科技股份有限公司、深圳顺络电子股份有限公司等。

（二）结合同行业可比公司情况，分析说明标的公司所处的行业地位和相较于主要竞争对手的经营优劣势

1、同行业可比公司情况

（1）同行业可比公司基本情况

综合考虑标的公司的生产经营模式、主要产品结构及业务重叠性等因素，选

取主要生产经营模式为 IDM 模式、主要产品为晶闸管、保护器件的 A 股上市公司作为可比公司，包括捷捷微电、台基股份、扬杰科技，具体情况如下：

企业名称	基本情况
捷捷微电 (300623.SZ)	捷捷微电成立于 1995 年，2017 年 3 月于深交所创业板上市。捷捷微电是一家专业从事功率半导体分立器件、电力电子器件研发、制造及销售的江苏省高新技术企业。捷捷微电产品主要应用于家用电器、漏断路等民用领域，无功补偿装置、电力模块等工业领域，及通讯网络、IT 产品、汽车电子等防雷击和静电保护领域。
台基股份 (300046.SZ)	台基股份成立于 2004 年，于 2010 年在深交所创业板上市。台基股份主要产品为大功率晶闸管、整流管、IGBT、电力半导体模块、脉冲功率开关等功率半导体器件及组件，广泛应用于工业变频器、电机驱动、高功率电源、数字能源、智能电网、轨道交通、新能源等电气系统和工控设备领域。
扬杰科技 (300373.SZ)	扬杰科技成立于 2006 年，于 2014 年在深交所创业板上市。扬杰科技专业致力于功率半导体芯片及器件制造、集成电路封装测试等领域的产业发展，主营产品为各类电力电子器件芯片、功率二极管、整流桥、大功率模块、DFN/QFN 产品、SGTMOS 及碳化硅 SBD、碳化硅 JBS 等，产品广泛应用于消费类电子、安防、工控、汽车电子、新能源等诸多领域。

(2) 标的公司与国内同行业公司比较情况

标的公司与国内同行业公司在收入规模、主要产品、生产经营模式上的比较情况如下：

单位：万元

名称	2024 年销售收入	2024 年净利润	主要产品	生产模式
捷捷微电	284,468.50	49,807.72	晶闸管器件和芯片、防护类器件和芯片、二极管器件和芯片、厚膜组件、晶体管器件和芯片、MOSFET 器件和芯片、IGBT 器件及组件等	IDM 为主、Fabless 为辅
台基股份	35,414.40	2,172.41	大功率晶闸管、整流管、IGBT、电力半导体模块、脉冲功率开关等功率半导体器件及组件	IDM 模式

名称	2024 年销售收入	2024 年净利润	主要产品	生产模式
扬杰科技	603,337.81	100,061.69	MOSFET、IGBT、SiC 系列产品、各类电力电子器件芯片、硅片等	IDM 与 Fabless 并行
标的公司	25,619.38	1,560.08	晶闸管、半导体防护类器件和芯片、功率半导体芯片、MOSFET 等	IDM 为主，Fabless 为辅

(3) 标的公司的行业地位

标的公司具有功率半导体芯片研发、生产和封装测试的综合竞争优势，专注于晶闸管和保护器件细分行业，以高性能、低成本的优势稳步在国内市场形成品牌影响力，是半导体分立器件领域内采用 IDM 经营模式的优秀企业之一。标的公司凭借长期的技术积累和自主创新，逐渐受到下游企业的重视和认可，通过了复杂的产品技术、生产工艺等前期质量认定程序，逐步实现较同类产品的技术优势，跻身我国半导体分立器件市场竞争中的第二梯队。

在晶闸管方面，以观知海内咨询预估的 2024 年中国晶闸管市场规模 30.96 亿元以及标的公司 2024 年晶闸管收入简单测算，标的公司在国内晶闸管领域的市场占有率约 5.09%，标的公司在晶闸管领域具有一定的市场占有率及品牌影响力。在保护器件方面，标的公司持续加强在保护器件系列产品的研发力度和投入，产品种类丰富，市场份额和市场地位也逐步提升。在具体产品方面，标的公司的主要产品，例如 E3V3V4UEF、E5V0X1BAI、E24V0U1BHJ、E48V0S1UAM 等 ESD 保护器件，在关键性能指标方面均不弱于国内外同行业公司竞品。未来标的公司将继续加大保护器件相关产品和技术的研发投入，以加强市场地位。

2、标的公司的主要经营优势

(1) 一体化产业链整合优势

有别于 Fabless 模式下专注于芯片设计这一单一生产环节，标的公司实现了芯片设计、晶圆制造、封装测试全工艺环节布局，这种产业链一体化模式不仅可灵活满足多样化客户需求并快速调整生产，更能通过上游源头把控和全流程协调，有效保障产品质量与缩短交货周期，及时响应市场变化。

(2) 技术研发与成熟工艺优势

标的公司作为高新技术企业，建立了大功率电子元器件研发中心，形成了完善的研发体系和品质管理保障体系，拥有一支经验丰富和创新能力较强的技术团队，能够把握技术发展趋势和市场需求变化，持续推进技术创新和产品升级。标的公司核心技术团队由江苏省双创人才李泽宏教授领衔技术研发工作，核心成员涵盖多位具有 10 余年以上功率半导体产品设计研发、工艺流程开发、芯片封装工艺开发、过程质量管理、市场销售服务经验的资深专家。标的公司研发成果丰富，截至目前累计获得专利 68 项，其中发明专利 33 项。标的公司在半导体领域深耕 20 余年，功率半导体芯片及器件制造工艺先进，产品性能良好、可靠性高，具有成熟的工艺技术优势；标的公司产品规格型号齐全，整体品质达到行业前列，得到了下游客户的广泛认可。

标的公司及子公司分别位于江苏及四川成都地区，江苏是国内集成电路产业最发达的地区之一，成都也是国内重要的电子信息产业基地，标的公司具有一定的区位和产业集群优势。在技术指标方面，标的公司晶闸管和保护器件的技术和性能指标已经达到了行业内同类型产品的先进水平，得到了客户的广泛认可，主要产品的技术性能指标与国内外主要竞争对手的对比情况如下：

1) 晶闸管

代表产品	代表参数	行业主流水平	吉莱微技术水平	代表参数作用特点
可控硅 JS013W	VRRM (越大越好)	800-1250V	$\geq 1400V$	应用于电力电子领域，VRRM 电压范围越宽，抗电网波动能力越强；IT(RMS) 电流越大，抗浪涌冲击能力越好
	IT(RMS) (越大越好)	0.47-1.25A	$\geq 1.25A$	
可控硅 S1215-8D	IT(RMS) (越大越好)	8A-12A	12A	应用于微型逆变器，IT(RMS) 电流越大，抗各种气候环境下的电流冲击能力越强；dv/dt 越大，抗电网波动能力越强
	ITSM (越大越好)	73-83A	140A	
	dv/dt (越大越好)	5-8V/us	$> 200V/us$	

代表产品	代表参数	行业主流水平	吉莱微技术水平	代表参数作用特点
可控硅模块 KT110-21T1	VRRM (越大越好)	1600-1800V	≥2100V	应用于电力电子，VRRM 电压范围越宽，抗电网波动能力越强

2) 保护器件

关键指标	标的公司产品 (E5VOX1BA1)	国际竞品甲 (RCI amp0561Z)	国内竞品乙 (AZ5B75-01B)	与同类产品对比情况
瞬态泄放电流(Ipp)	2.5A	2.5A	/	达到国际同类产品水平
钳位电压(Vc)	14V@1A; 18V@2A	16.5V@2A	/	达到国际同类产品水平
结电容(Cj)	0.08pF	0.12pF	0.18pF	优于国际及国内同类产品水平

关键指标	标的公司产品 (E24VOU1BHJ)	国际竞品丙 (PESD24VF1BBL)	国内竞品丁 (ESD73211N)	与同类产品对比情况
瞬态泄放电流(Ipp)	9A	/	5.5A	优于国内同类产品
钳位电压(Vc)	<7V@9A; 8V@16A (TLP)	20V@16A (TLP)	<7.5V@5.5A;	优于国际及国内同类产品
结电容(Cj)	0.3pF	0.28pF	0.6pF	电容与国际同类产品相当，优于国内同类产品

(3) 成本领先及品牌优势

标的公司通过深度集成信息化软件与自动化设备（如 ERP/MES 系统），并严格遵循 ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001 及 IATF 16949 质量管理体系要求，结合自有专利技术，能够有效提升效率、优化工艺、降低成本，构建先进制造体系下的成本领先优势。凭借在产品性能与成本控制的综合实力，以及多年行业积

累，标的公司已与比亚迪、安世半导体等知名客户建立稳定合作，赢得了市场广泛认可，逐步形成了自身品牌优势。

3、标的公司存在的不足或经营劣势

(1) 经营规模相对较小

与同行业已上市的主要竞争对手相比，标的公司当前的资产体量（如净资产总额、总资产规模）、经营规模（如产能、营业收入、市场份额及业务覆盖范围）仍相对较小，在面对频繁的市场需求波动、剧烈的行业周期性变化或重大的突发事件冲击时，其风险抵御、调整适应和抗压恢复等应对外部冲击的能力相对较弱。

(2) 融资渠道单一

标的公司发展所需资金主要依赖股东投入、自身盈利积累和银行借款。半导体行业具有研发投入大、资金密集、投资回报周期长的特点。在现有基础上，标的公司仍需持续投入资金以扩充产能、开发新产品、扩大经营规模。长远来看，若不能拓宽融资渠道，当前的融资方式将制约标的公司的研发创新、生产经营及未来发展。

(3) 大额股份回购引致的现金流压力及潜在经营风险

标的公司于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购部分股东所持有公司股份的议案》，同意标的公司回购其他机构投资者所持有的标的公司全部股份。基于该情况，标的公司后续需支付大额现金对价以回购其他机构投资者所持股份，此举将导致其后续经营期间面临一定的现金流压力，进而可能诱发营运资金短缺风险，对标的公司的正常经营构成潜在威胁。

上述楷体加粗部分已在本次交易预案第四节之“三、标的公司主营业务情况”中补充披露。

二、结合上市公司的主业经营情况、发展战略，说明本次交易与上市公司主业的协同性，是否有助于提高上市公司资产质量

(一) 上市公司的主业经营情况、发展战略

公司长期以来聚焦信息科技、新能源、股权投资三大核心业务板块，全力推动主营业务提质增效，夯实内生增长动力，同时积极探索产业链上下游的外延式发展机会。最近两年公司营业收入按产品划分如下：

单位：万元

项目（万元/%）	2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比
芯片设计及应用	9,145.23	26.29%	11,823.64	36.76%
太阳能电站	16,046.20	46.12%	13,035.06	40.52%
计算机信息技术服务	3,248.01	9.34%	2,553.27	7.94%
手机游戏	1,199.78	3.45%	1,162.47	3.61%
环保设备及环保材料	1,598.00	4.59%	0.00	0.00%
餐饮、租赁及其他	3,552.97	10.21%	3,593.18	11.17%
合计	34,790.19	100.00%	32,167.62	100.00%

在发展战略方面，公司始终以国家战略为导向，顺应市场经济发展规律，积极应对宏观环境和行业政策变化，紧跟前沿信息技术革新步伐，以核心技术为引擎推动创新，聚焦信息科技、新能源、股权投资等核心业务领域，深挖内在潜力，推动公司实现精细化管理与卓越化发展，提升盈利水平、增强风险抵御能力。

在夯实主营业务、固本强基的同时，公司积极深化在信息科技领域的前瞻性战略布局力度，积极挖掘、探索新形势下高科技产业的外延发展机会，并通过与旗下子公司的紧密协作，形成协同发展效应，实现资源共享与优势互补，培育和构建高质量、多元化的发展新格局，不断提升公司的内在价值，强化核心竞争力，致力于稳健可持续发展的长远目标。

（二）本次交易与上市公司主业具有协同性，有助于提高上市公司资产质量

本次交易与上市公司主营业务具有协同性，有助于提高上市公司资产质量。具体说明如下：

1、产业链互补与拓展

上市公司当前集成电路业务以芯片设计为主，而标的公司在功率半导体制造领域具备成熟技术和产能，二者存在互补性。标的公司拥有多条晶圆生产线，包括 4 英寸、5 英寸以及在建的 6 英寸生产线，配套兼容 4 英寸、5 英寸、6 英寸和 8 英寸芯片封装测试的生产线。本次交易完成后，上市公司将与标的公司进

行充分论证，探讨后续业务整合的可行性。标的公司生产线为功率半导体芯片和器件的生产提供了坚实的基础，如顺利实现整合，上市公司的芯片设计能力可以与标的公司的制造能力充分结合，进而实现产业链互补。上述整合将使得上市公司能够更好地控制产品质量和成本，在市场竞争中更具优势。

2、技术创新协同

在技术创新协同方面，上市公司在芯片设计上的技术优势与标的公司在功率半导体制造工艺上的成熟技术相互结合，能够加速产品的研发进程。一方面，上市公司的设计理念可通过标的公司先进制造工艺更好实现，提升产品性能和品质；另一方面，标的公司制造经验可为上市公司产品设计提供验证，使设计方案更贴合实际生产需求。同时，双方可联合推进研发项目，拓展新技术路径与应用场景。例如，上市公司及子公司在模拟信号功率驱动的技术积累，和标的公司在功率器件设计生产的技术，可助力研发低功耗大输出功率的模拟信号驱动器件，如助听器应用，并推广至其他电池供电设备。

3、资源共享及业务协同

上市公司在多年发展中积累了显著的客户资源及渠道优势。标的公司聚焦功率半导体芯片及器件领域，亦积累了相应客户资源。在客户资源协同方面，由于双方客户群体存在差异，上市公司可依托标的公司客户基础推广集成电路设计产品，标的公司亦能借助上市公司销售网络拓展新市场。两者联合服务客户，既能拓展市场覆盖范围，又能降低营销成本，提升客户满意度及忠诚度。例如，上市公司下属企业涉及国产自主知识产权工业级处理器，主要应用于工业控制领域，其配套产品需要大量保护器件及芯片，而这是标的公司的主要产品。收购完成后，通过内部业务整合，标的公司业务渠道可进一步完善和拓宽。

4、战略布局与未来发展

本次交易为上市公司战略布局和未来发展提供了新的机遇。功率半导体作为集成电路产业关键领域，其技术及市场发展对整个行业具有重要影响。通过标的公司协同，上市公司可深入把握功率半导体领域发展趋势与市场需求，为未来布局更广阔的集成电路设计、制造或封装测试领域提供关键技术储备与人才支撑。同时，双方合作为未来拓展其他领域奠定基础，通过技术与市场延伸开拓新业务空间。

综上，本次交易与上市公司主业具有协同性，有助于提高上市公司资产质量。

上述楷体加粗部分已在本次交易预案及预案摘要第一节之“八、本次交易与上市公司主业的协同性，是否有助于提高上市公司资产质量”中补充披露。

2、关于标的公司业绩承诺

相关公开信息显示，2021年吉莱微实现营业收入、归母净利润分别为3.01亿元、0.70亿元。预案显示，2023年、2024年和2025年一季度，吉莱微分别实现营业收入2.36亿元、2.56亿元和0.49亿元，同期分别实现净利润0.14亿元、0.16亿元和0.04亿元。本次交易设置四年业绩承诺期，业绩承诺方承诺吉莱微2025年至2028年分别实现净利润2600万元、3300万元、4100万元、5000万元，累计承诺净利润不低于1.5亿元。上述年度净利润相较2024年净利润的增幅分别66.67%、111.54%、162.82%、220.51%。

请公司：（1）结合报告期内标的公司的主要客户、供应商情况，产品结构、产销量、毛利率等情况，分析说明标的公司近年来经营业绩相较于2021年降幅较大的原因，与同行业可比公司是否存在差异，报告期内主要客户是否发生重大变化；（2）补充披露标的公司报告期内分季度收入数据，结合收入的季节性波动情况、今年以来的经营业绩等情况，说明标的公司2025年全年经营业绩是否存在下滑风险；（3）结合标的公司业务发展规划及业务开展情况，包括但不限于在手订单数量、金额、执行情况、销售毛利率、产品线开发进展、资产折旧情况及减值风险等，说明标的公司业绩承诺期内收入、净利润等测算依据、具体过程及其合理性，并结合标的公司历史业绩情况说明业绩承诺的可实现性。请独立财务顾问发表意见，请评估师对问题（3）发表意见。

【回复】

一、结合报告期内标的公司的主要客户、供应商情况，产品结构、产销量、毛利率等情况，分析说明标的公司近年来经营业绩相较于2021年降幅较大的原因，与同行业可比公司是否存在差异，报告期内主要客户是否发生重大变化

（一）报告期内标的公司的主要客户

报告期内，标的公司的前五大客户情况如下：

单位：万元

年度	序号	客户名称	销售模式	销售内容	销售收入	占当期销售收入的比例
2025年1-3月	1	上海维安半导体有限公司	直销	ESD 芯片、TSS 芯片、TVS 芯片等	312.77	6.35%
	2	乐清吉莱电子有限公司	经销	晶闸管	267.97	5.44%
	3	重庆力华自动化技术有限责任公司	直销	晶闸管	235.33	4.78%
	4	乐山无线电股份有限公司	直销	ESD 芯片、TSS 芯片、TVS 芯片等	223.34	4.54%
	5	宁波佳荣电子科技有限公司	经销	晶闸管、MOS 管等	205.07	4.17%
	小计					1,244.49
2024年度	1	乐清吉莱电子有限公司	经销	晶闸管、晶闸管芯片等	1,883.33	7.35%
	2	上海维安半导体有限公司	直销	ESD 芯片、TSS 芯片、TVS 芯片等	1,837.20	7.17%
	3	温州仙童电子科技有限公司	直销	晶闸管	1,326.26	5.18%
	4	乐山无线电股份有限公司	直销	ESD 芯片、TSS 芯片、TVS 芯片等	883.87	3.45%
	5	常州睿达丰电子有限公司	经销	晶闸管、晶闸管芯片等	881.9	3.44%
	小计					6,812.56
2023年度	1	乐清吉莱电子有限公司	经销	晶闸管、晶闸管芯片等	1,878.65	7.95%
	2	上海维安半导体有限公司	直销	TSS 芯片、TVS 芯片、ESD 芯片等	1,682.45	7.12%
	3	温州仙童电子科技有限公司	直销	晶闸管	1,034.21	4.38%
	4	乐山无线电股份有限公司	直销	ESD 芯片、TSS 芯片、TVS 芯片等	949.37	4.02%
	5	重庆力华自动化技术有限责任公司	直销	晶闸管	926.81	3.92%
	小计					6,471.50

标的公司采用直销和经销相结合的销售模式，其中功率半导体芯片采用以直

销为主的销售模式，功率半导体器件采用经销为主的销售模式，上述销售结构属于半导体行业普遍采用的销售模式。标的公司的下游主要客户包括经销商和电子元器件制造商。以标的公司主要客户为例，上海维安半导体有限公司成立于 2008 年，主要从事电路保护产品和功率控制产品的生产和销售，标的公司产品配套于该公司的安防领域产品，最终应用于海康威视、大华股份等电子终端设备厂商；重庆力华自动化技术有限责任公司成立于 1989 年，主要从事摩托车电器、通机电器、汽车电器、数码电机逆变器等电子产品的研发、生产和销售，主要向标的公司采购晶闸管；乐山无线电股份有限公司成立于 1971 年，是国内最大的分立半导体器件制造企业之一，其产品种类较多，主要向标的公司采购保护器件芯片。

（二）报告期内标的公司的主要供应商情况

报告期内，标的公司前五大供应商及采购金额占比情况如下：

单位：万元

年度	序号	供应商名称	采购内容	采购金额	占当期采购总额的比例
2025 年 1-3 月	1	启东市供电局	电力	284.42	10.33%
	2	无锡市长通敏感电器厂	引线框架	255.62	9.28%
	3	泰州东田电子有限公司	引线框架	244.74	8.89%
	4	浙江中晶科技股份有限公司	硅磨片（单晶片）	133.83	4.86%
	5	辽阳雄乾电子科技有限公司	引线框架	126.33	4.59%
	小计			1,044.94	37.95%
2024 年 度	1	江苏银洲建设集团有限公司	建造施工	3,705.85	14.81%
	2	南通胤广建设工程有限公司	建造施工	3,079.24	12.30%
	3	启东市供电局	电力	1,626.20	6.50%
	4	泰州东田电子有限公司	引线框架	1,497.99	5.99%
	5	无锡市长通敏感电器厂	引线框架	1,281.18	5.12%
	小计			11,190.46	44.71%
2023 年 度	1	启东市供电局	电力	1,417.76	8.83%
	2	泰州东田电子有限公司	引线框架	1,311.06	8.17%
	3	江苏银洲建设集团有限公司	建造施工	1,009.17	6.29%

年度	序号	供应商名称	采购内容	采购金额	占当期采购总额的比例
	4	无锡市长通敏感电器厂	引线框架	926.64	5.77%
	5	南通胤广建设工程有限公司	建造施工	825.69	5.14%
		小计		5,490.32	34.19%

(三) 标的公司的产品结构

报告期内，标的公司的产品结构情况如下：

单位：万元

产品类别	项目	2025年1-3月			2024年度			2023年度	
		金额	占比	同比	金额	占比	同比	金额	占比
功率半导体器件	晶闸管	2,861.51	58.27%	-12.14%	15,756.67	61.96%	9.32%	14,413.24	61.38%
	ESD 成品	321.80	6.55%	62.33%	965.62	3.80%	30.95%	737.40	3.14%
	其他	219.98	4.48%	39.32%	981.91	3.86%	6.67%	920.49	3.92%
	小计	3,403.29	69.30%	-5.80%	17,704.19	69.62%	10.16%	16,071.12	68.44%
功率半导体芯片	保护器件芯片	1,339.91	27.29%	0.14%	7,210.60	28.35%	4.18%	6,921.27	29.47%
	其他	167.51	3.41%	102.83%	516.04	2.03%	5.08%	491.10	2.09%
	小计	1,507.42	30.70%	6.11%	7,726.64	30.38%	4.24%	7,412.37	31.56%
合计		4,910.71	100.00%	-2.44%	25,430.84	100.00%	8.29%	23,483.49	100.00%

注：保护器件芯片包括 ESD 芯片、TVS 芯片、TSS 芯片等产品，下同。

标的公司专业从事功率半导体芯片及器件的研发、生产和销售，主要产品为应用于消费电子、工业、通讯安防和汽车电子等领域的功率半导体器件和功率半导体芯片。报告期内，标的公司功率半导体器件的收入规模分别为 16,071.12 万元、17,704.19 万元和 3,403.29 万元，占主营业务的比重分别为 68.44%、69.62% 和 69.30%，是标的公司主营业务收入的主要来源。功率半导体器件细分领域中，报告期内晶闸管、ESD 成品的销售规模均有所增长，且 ESD 成品的销售占比也不断提高，主要原因系 ESD 成品报告期内处于逐步成长爬坡阶段，随着与下游客户进一步深化合作，销量也随之增长。报告期内，标的公司 ESD 成品销售增长主要系上海典呈国际贸易有限公司销量有所增长所致，标的公司对其 ESD 成品的销售情况如下：

单位：万元

客户	2025年1-3月	2024年度	2023年度
上海典呈国际贸易有限公司	130.64	386.83	52.45

功率半导体芯片细分领域中，2024年标的公司功率半导体芯片较2023年增长了4.24%，主要增量来自于保护器件芯片中的TVS芯片、TSS芯片，但同期ESD芯片同比有所下降，主要原因系主要客户成都先进功率半导体股份有限公司、无锡维矽半导体科技有限公司等根据自身的业务需求减少了对ESD芯片的订单，标的公司报告期内对前述客户的ESD芯片销售情况如下：

单位：万元

客户	2025年1-3月	2024年度	2023年度
成都先进功率半导体股份有限公司	29.87	522.71	710.11
无锡维矽半导体科技有限公司	77.12	345.29	463.18

（四）标的公司的产销量

报告期内，标的公司的产品产销量情况如下：

产品	项目	2025年1-3月	2024年度	2023年度
功率半导体器件	产量（万只）	10,253.85	57,304.70	53,508.86
	销量（万只）	10,428.58	55,834.27	53,600.27
	产销率	101.70%	97.43%	100.17%
功率半导体芯片	产量（万片）	21.86	120.23	108.22
	器件生产耗用量（万片）	8.03	43.78	35.95
	销量（万片）	13.79	76.29	66.65
	产销率	99.83%	99.86%	94.81%

注：功率半导体器件产能、产量和销量为晶闸管器件的产能、产量和销量，委外生产的ESD器件和MOSFET器件未包含在公司功率半导体器件的产能、产量和销量统计中。因产品分类口径因素，产销量未按照细分产品列示。

（五）标的公司的毛利率

报告期内，标的公司主要产品的毛利率情况如下：

产品类别	项目	2025年1-3月		2024年度		2023年度
		毛利率	变动	毛利率	变动	毛利率
功率半导体器件	晶闸管	13.56%	-4.70%	18.26%	0.43%	17.83%
	ESD成品	23.34%	-0.61%	23.94%	2.87%	21.08%
	其他	9.95%	3.38%	6.57%	1.52%	5.05%

产品类别	项目	2025年1-3月		2024年度		2023年度
		毛利率	变动	毛利率	变动	毛利率
	小计	14.00%	-3.92%	17.92%	0.67%	17.25%
功率半导体芯片	保护器件芯片	37.22%	6.34%	30.88%	-6.17%	37.05%
	其他	30.71%	-2.17%	32.88%	-4.69%	37.58%
	小计	36.50%	5.48%	31.01%	-6.07%	37.08%
合计		20.90%	-0.99%	21.90%	-1.61%	23.51%

由上表可知，功率半导体器件 2024 年毛利率略有上升，一方面原因系 2024 年晶闸管毛利率略有上升，另一方面产品中单价较高、毛利率较高的 ESD 成品占比有所上升；2025 年 1-3 月标的公司功率半导体器件毛利率有所下降，主要原因系一季度受春节假期的影响，整体产量相对较少，相应的单位分摊成本较高，导致晶闸管和 ESD 产品的毛利率均有所下滑。

功率半导体芯片 2024 年毛利率有所下降，主要原因系当年对该品类大客户上海维安半导体有限公司的销售价格有所下调所致，该客户的采购规模较大，从长远合作角度考虑，标的公司在价格方面给予了一定下调；2025 年 1-3 月芯片毛利率有所回升，主要系当期标的公司对外销售的保护器件芯片中的 TVS 芯片中，对上海维安半导体有限公司等毛利率较低的客户销售占比较低，毛利率较高的客户如乐山无线电股份有限公司等销售占比较高，带动了芯片类别整体毛利率的回升。

（六）标的公司近年来经营业绩相较于 2021 年降幅较大的原因

标的公司 2021 年经营业绩较高，主要原因系 2019 年-2021 年期间，受行业周期性波动影响，功率半导体产品的市场供给情况较为紧张，行业内公司整体处于快速扩产的阶段，受益于此标的公司产品的平均单价有所提高，同时销量上升带来规模效应，使得产品单位成本有所下降，标的公司 2021 年度的整体毛利率较高，导致 2021 年经营业绩较高。具体而言，2021 年标的公司的核心产品为晶闸管器件和保护器件芯片，这两类产品收入占标的公司当年营业收入的比重在 90% 以上。在产品平均单价方面，2021 年标的公司晶闸管器件的平均单位价格同比增长了 12.52%，平均单位成本同比增长仅 5.38%；保护器件芯片的平均单位价格同比增长了 12.15%，平均单位成本同比下降了 12.46%。上述产品单位售价和单位成本的变动有效提高了标的公司毛利率水平和经营业绩。

2022 年开始，行业整体处于产能消化以及去库存阶段。针对标的公司经营情况，鉴于前期乐观情绪下，标的公司新增的设备投入有所加大，导致单位成本有所上升，导致标的公司近年来毛利率下降，经营业绩有所下降。以标的公司的主要产品晶闸管器件为例，2023 年、2024 年、2025 年 1-3 月，标的公司主要产品晶闸管器件的平均售价较 2021 年的变动幅度分别为-0.93%、3.93%、3.38%，变动幅度较小；在平均成本方面，2023 年、2024 年、2025 年 1-3 月，晶闸管器件的平均成本较 2021 年的变动幅度分别为 23.20%、28.58%、35.25%，增长幅度较大，这导致报告期内毛利率较 2021 年下降较多。晶闸管产品平均成本上升的主要原因，一方面系标的公司前期乐观情绪下新增的设备投入增大，导致产品单位成本上升较多，另一方面报告期内标的公司主要原材料引线框架的采购成本有所上升，引线框架的主材为铜，2024 年至今铜价呈上涨趋势，对标的公司的原材料成本造成了一定影响。

针对晶闸管产量变化和成本波动，2024 年晶闸管器件的产量为 57,304.70 亿只，较 2023 年增长了 7.09%，原则上规模效应将导致产品单位成本有所下降，但当期引线框架的平均采购成本上升了约 9.01%，导致单位成本仍存在小幅上涨。2025 年 1-3 月，晶闸管器件的平均成本较 2021 年增幅较大，当期引线框架的平均采购成本较 2024 年上升了约 9.17%，同时当期受春节假期因素影响，产量较小，晶闸管分摊的单位成本较高。

整体而言，与 2021 年相比标的公司经营业绩存在一定回落，但近年来其整体经营规模保持持续增长，产品结构持续优化成熟，相应的标的公司整体毛利率趋于稳定，随着后续行业需求的不断提升以及标的公司内生动力增强，标的公司收入预计将保持稳定增长。

（七）与同行业可比公司是否存在差异

经查阅同行业上市公司捷捷微电、台基股份、扬杰科技近年来的毛利率，与标的公司对比如下：

公司	2025 年 1-3 月	2024 年度	2023 年度	2021 年度
捷捷微电	39.93%	36.34%	34.13%	47.70%
台基股份	28.98%	29.45%	23.19%	30.48%

公司	2025年1-3月	2024年度	2023年度	2021年度
扬杰科技	34.60%	33.08%	30.26%	35.11%
平均值	34.50%	32.96%	29.19%	37.76%
标的公司	21.08%	22.09%	23.55%	39.29%

注：表中毛利率为各公司的综合毛利率。

由上表可知，同行业可比公司近年来的毛利率较2021年亦存在一定程度的下降，标的公司的毛利率下降幅度高于同行业可比公司，主要原因系标的公司的业务规模相对较小，产品单位成本对业务规模的敏感性更高。

同行业可比公司捷捷微电、台基股份、扬杰科技等均为上市公司，捷捷微电、台基股份、扬杰科技2024年毛利率相对于2023年度有所回升。通过查询公开披露信息，捷捷微电子公司捷捷微电（南通）科技有限公司2022年度、2023年度存在亏损，随着产能逐渐爬坡，2024年捷捷微电（南通）科技有限公司实现营业收入101,515.37万元、利润总额14,893.26万元，有效提高了捷捷微电整体毛利率水平；根据台基股份披露的定期报告，其2024年高端产品与高毛利产品的占比提升，如高附加值大功率器件、数字能源领域器件、变频器领域和IGBT器件等销量持续上升，显著提升了其盈利能力和毛利率水平；根据扬杰科技公开披露的定期报告，2024年其汽车电子业务在客户端及应用场景均取得突破，营业收入较去年同期上升超60%，且在2024年持续开展增效降本的一系列活动，有效提升全流程效率和降低成本费用，新产品扩展及增效降本措施收益成效明显，推动了整体毛利率稳步提升。

与同行业可比上市公司相比，标的公司仍处于持续投入、产能爬坡的过程中，且标的公司的融资成本高、融资渠道单一，相应的标的公司整体的盈利能力低于同行业上市公司。

（八）报告期内主要客户是否发生重大变化

报告期内各年度前五大客户的销售排名情况如下：

客户名称	2025年1-3月	2024年	2023年
上海维安半导体有限公司	1	2	2
乐清吉莱电子有限公司	2	1	1

客户名称	2025年1-3月	2024年	2023年
重庆力华自动化技术有限责任公司	3	9	5
乐山无线电股份有限公司	4	4	4
宁波佳荣电子科技有限公司	5	7	7
温州仙童电子科技有限公司	15	3	3
常州睿达丰电子有限公司	8	5	9

由上表可知，报告期内标的公司各年度前五大客户与标的公司均保持正常合作，2025年1-3月温州仙童电子科技有限公司、常州睿达丰电子有限公司排名有所下降，主要原因系上述客户根据自身业务需求情况进行采购，当期的采购额有所减少导致排名有所变化，其与标的公司的业务合作关系仍保持正常。报告期内标的公司主要客户未发生重大变化。

二、补充披露标的公司报告期内分季度收入数据，结合收入的季节性波动情况、今年以来的经营业绩等情况，说明标的公司2025年全年经营业绩是否存在下滑风险

标的公司报告期内分季度主营业务收入情况具体如下：

单位：万元

季度	2025年1-3月			2024年度			2023年度		
	金额	占比	同比变动	金额	占比	同比变动	金额	占比	同比变动
一季度	4,910.71	100.00%	-2.44%	5,033.61	19.79%	8.31%	4,647.39	19.79%	0.27%
二季度	-	-	-	6,861.76	26.98%	13.89%	6,024.71	25.66%	-2.70%
三季度	-	-	-	6,746.76	26.53%	8.69%	6,207.39	26.43%	16.07%
四季度	-	-	-	6,788.71	26.69%	2.80%	6,604.00	28.12%	22.56%
总计	4,910.71	100.00%	-	25,430.84	100.00%	8.29%	23,483.49	100.00%	8.75%

标的公司产品广泛应用于以家电为代表的消费电子领域、以低压电器为代表的工业领域以及以手机和摄像头为代表的网络通讯和安防领域等，受元旦春节假期影响，下游厂家一般会在四季度加大采购及生产规模，四季度提前备货的情况较为普遍，相应的四季度对标的公司产品的需求量增加。上述因素导致标的公司一季度收入占比相对较低而四季度收入占比相对较高。

2025年第一季度标的公司的主营业务收入较上年同期小幅波动，2025年第

一季度收入构成与上年同期相比变动情况如下：

单位：万元

产品类别	项目	2025年1-3月				2024年1-3月	
		金额	占比	同比变动额	同比变动	金额	占比
功率半导体器件	晶闸管	2,861.51	58.27%	-395.35	-12.14%	3,256.86	64.70%
	ESD成品	321.80	6.55%	123.56	62.33%	198.24	3.94%
	其他	219.98	4.48%	62.09	39.32%	157.89	3.14%
	小计	3,403.29	69.30%	-209.70	-5.80%	3,612.99	71.78%
功率半导体芯片	保护器件芯片	1,339.91	27.29%	1.88	0.14%	1,338.03	26.58%
	其他	167.51	3.41%	84.92	102.83%	82.59	1.64%
	小计	1,507.42	30.70%	86.80	6.11%	1,420.62	28.22%
合计		4,910.71	100.00%	-122.90	-2.44%	5,033.61	100.00%

2025年一季度标的公司收入较上年同期小幅波动，主要原因系公司主要客户温州仙童电子科技有限公司、常州睿达丰电子有限公司等客户根据自身业务需求情况进行采购，当期采购的晶闸管产品有所减少导致。

经公开查询发现，同行业可比公司的收入存在季节性波动，具体情况如下：

单位：万元

可比公司	季度	2025年1-3月		2024年度		2023年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
捷捷微电	一季度	69,991.78	100.00%	51,954.44	18.26%	40,337.49	19.15%
	二季度			74,297.05	26.12%	49,765.17	23.63%
	三季度			74,349.18	26.14%	52,542.87	24.94%
	四季度			83,867.84	29.48%	67,990.49	32.28%
	总计	69,991.78	100.00%	284,468.50	100.00%	210,636.02	100.00%
扬杰科技	季度	2025年1-3月		2024年度		2023年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
	一季度	157,909.62	100.00%	132,804.38	22.01%	131,045.07	24.22%
	二季度			153,721.14	25.48%	131,429.17	24.29%
	三季度			155,836.26	25.83%	141,592.80	26.17%
	四季度			160,976.02	26.68%	136,916.45	25.31%

	总计	157,909.62	100.00%	603,337.81	100.00%	540,983.50	100.00%
台基股份	季度	2025年1-3月		2024年度		2023年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
	一季度	7,446.02	100.00%	7,904.18	22.32%	7,879.24	24.64%
	二季度			9,257.92	26.14%	8,510.88	26.62%
	三季度			8,477.65	23.94%	8,181.07	25.59%
	四季度			9,774.65	27.60%	7,402.07	23.15%
	总计	7,446.02	100.00%	35,414.40	100.00%	31,973.26	100.00%

由上表可知，同行业可比公司收入也存在一定的季节性波动，整体来看，在季节性波动方面，标的公司与同行业可比公司不存在明显差异。但在2025年一季度收入变化方面，捷捷微电、扬杰科技2025年1-3月收入存在较大上涨，但标的公司基本与去年同期持平，与可比公司存在一定差异，具体说明如下：

2025年1-3月，捷捷微电的营业收入较上年同期有所增长，经查询其公开披露信息，其2024年功率半导体器件和芯片收入增长主要得益于公司控股子公司捷捷微电（南通）科技有限公司生产设备的先进性和产能提升，2025年第一季度具有一定的延续性；2025年1-3月，扬杰科技的营业收入较上年同期有所增长，经查询其公开披露信息，其2024年汽车电子业务在客户端及应用场景均取得突破，营业收入较去年同期上升超60%，且未来增长动能强劲，相应的2025年第一季度具有一定的延续性。综上，捷捷微电与扬杰科技2025年1-3月收入增长主要系业务开拓情况较为良好所致。

根据标的公司管理层初步测算，2025年1-6月，标的公司营业收入预计为1.15-1.25亿元，营业收入较上年同期变动幅度为-3.32%至5.08%，净利润预计为900-1,000万元，净利润预计较上年同期增长11.72%-24.14%。根据标的公司的在手订单及经营情况，预计2025年全年经营业绩基本不存在下滑风险。

随着标的公司持续深化核心产品的市场推广力度，预期业绩将实现稳健增长。在后续业务规模扩张方面，标的公司的主要措施包括：1、深化现有核心客户合作：通过提升综合服务能力、强化品牌影响力及优化客户关系，持续扩大标的公司在现有核心客户中的采购份额并增强客户黏性；2、拓展新兴应用市场：积极布局新能源汽车、充电桩等高增长潜力领域（当前客户包括比亚迪电子（国

际)有限公司、安世半导体(中国)有限公司、深圳市艾特网能电能有限公司等),借助定制化解决方案和市场渗透策略,逐步开发并扩大相关业务;3、强化研发与产品迭代:持续增加研发投入,专注技术创新与核心能力建设,依据市场需求与技术趋势,系统推进年度产品更新与技术路线图实施,确保技术领先性与产品竞争力。

在业务赋能方面,上市公司于信息技术领域长期深耕,核心业务涵盖集成电路设计及应用(含集成电路与智能卡业务)、移动游戏及信息技术服务等板块,并积累了显著的客户资源与渠道优势。本次重大资产购买完成后,标的公司作为控股子公司纳入上市公司管理体系。上市公司将整合其客户资源与渠道优势对标的公司实施赋能,以拓宽其客户群体与收入来源,提升其营收规模。

上述楷体加粗部分已在本次交易预案第四节之“三、标的公司主营业务情况”之“(七)标的主要财务指标”中补充披露。

三、结合标的公司业务发展规划及业务开展情况,包括但不限于在手订单数量、金额、执行情况、销售毛利率、产品线开发进展、资产折旧情况及减值风险等,说明标的公司业绩承诺期内收入、净利润等测算依据、具体过程及其合理性,并结合标的公司历史业绩情况说明业绩承诺的可实现性

(一) 标的公司业务发展规划、业务开展情况,以及业绩承诺期内收入、净利润等测算依据、具体过程及其合理性

在业务发展规划方面,自设立以来标的公司始终坚持以创新发展为导向,不断拓展产品线和产品应用领域,从单品类产品到多品类产品,从区域市场到国内市场,从个别应用领域到多个应用领域,标的公司已经发展成为功率半导体器件细分行业的主要供应商之一。

1、标的公司过往业绩情况

标的公司深耕功率半导体器件领域多年,在行业内积累了丰富的技术经验和客户资源。标的公司近年来的财务数据情况具体如下:

单位:万元

项目	实际经营情况		
	2024 年	2023 年	2021 年
营业收入	25,619.38	23,625.95	30,104.13
对应增长率	8.44%	8.56%	-
毛利	5,659.32	5,563.91	11,827.91
毛利率	22.09%	23.55%	39.29%
期间费用、营业税金及附加	4,056.58	4,170.84	3,930.29
期间费用、营业税金及附加占营业收入的比例	16.28%	17.17%	13.06%
净利润	1,560.08	1,395.60	6,996.40
净利率	6.09%	5.91%	23.24%

注：鉴于 2022 年度不属于本次重大资产重组报告期，也不属于标的公司前次 IPO 报告期，因此未列示具体数据。

在过往业绩方面，根据标的公司前次 IPO 公开披露的财务数据显示，2021 年度标的公司合计实现营业收入 30,104.13 万元，实现净利润 6,996.40 万元。受行业周期性波动影响，2022 年开始行业整体处于产能消化以及去库存阶段，标的公司经营业绩相应也有所下降。近年来，随着行业调整逐步完成，标的公司业绩也有所增长，2023 年标的公司营业收入同比上升 8.56%，2024 年标的公司的营业收入较 2023 年度提高了 8.44%，收入增长趋势较为良好。

2、标的公司业绩承诺期内收入、净利润预计情况说明

关于未来业绩预期，根据标的公司管理层判断，业绩承诺期内标的公司的预计收入、净利润等情况具体如下：

单位：万元

项目	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	合计
预计收入	28,821.80	32,424.53	36,477.59	41,037.29	-
对应增长率	12.5%	12.5%	12.5%	12.5%	-
预计毛利	7,493.67	8,754.62	10,213.73	11,900.81	-
对应毛利率	26%	27%	28%	29%	-
期间费用、营业税金及其他	4,755.60	5,350.05	6,018.80	6,771.15	-
期间费用、营业税金及其他，合计占营业收入的比例	16.5%	16.5%	16.5%	16.5%	-

项目	2025年	2026年	2027年	2028年	合计
预计净利润	2,738.07	3,404.58	4,194.92	5,129.66	15,467.23
对应净利率	9.5%	10.5%	11.5%	12.5%	
业绩承诺净利润	2,600.00	3,300.00	4,100.00	5,000.00	15,000.00

注：上表系在设定收入增长率及净利润率的前提下模拟测算的标的公司未来净利润水平，不构成盈利预测或评估测算结果。

结合对行业发展和标的公司经营情况的整体判断，标的公司管理层预估业绩承诺期内标的公司年均收入复合增长率约 10%-15%，上表以其均值 12.5% 作为收入增长率；毛利率将逐步趋于同行业可比公司平均水平，业绩承诺期内分别为 26%、27%、28% 和 29% 作为毛利率预测值；净利率随着毛利率的增长逐步提升，业绩承诺期内分别以 9.5%、10.5%、11.5% 和 12.5% 作为净利率预测值，以此为基础简单测算，标的公司业绩承诺期内的预计净利润分别为 2,738.07 万元、3,404.58 万元、4,194.92 万元和 5,129.66 万元，合计为 15,467.23 万元，与标的公司业绩承诺方承诺的净利润较为吻合。

上述预测为标的公司管理层基于行业发展和标的公司经营情况分析并得出，尚需进一步论证，后续标的公司将在审计、评估工作完成后，对上述业绩预期情况进行审慎调整。以下基于标的公司经营情况和管理层预期，具体说明标的公司上述收入、毛利率等指标的预测依据和测算过程：

(1) 在手订单数量、金额及执行情况

标的公司所属行业为功率半导体行业，行业内企业与下游客户的合作关系一般较为稳定，客户需求存在持续性。在合作模式方面，标的公司一般会与主要客户签订年度框架合同，客户再根据实际需求每月向公司下订单，在手订单数量、金额与标的公司后续承诺净利润的实现情况呈正相关。

截至 2025 年 6 月 30 日，标的公司在手订单数量、金额等情况具体如下：

项目	截至 2025 年 6 月 30 日	
	金额（万元）	数量
功率半导体芯片	2,567.73	22.59 万片
功率半导体器件	2,748.84	27,236.00 万只

合计	5,316.57	-
----	----------	---

注：以上在手订单系按照客户已下单但标的公司未交货进行梳理统计。

2024年6月30日，标的公司在手订单金额约4,981.49万元，对比2024年6月30日的在手订单情况，标的公司2025年6月30日的在手订单金额同比增长了6.73%。需要说明的是，上述在手订单的同比增长率尚未达到标的公司业绩承诺期内10%-15%的收入复合增长率。业绩承诺期内的收入增长率，系标的公司管理层基于对行业和标的公司经营情况的预估，尚需进一步论证和分析，待标的公司审计、评估工作完成后，上市公司将在重组报告书中对标的公司业绩承诺等重要事项进行审慎论证并及时披露。

经与标的公司管理层沟通，虽然在手订单的同比增长率低于收入预期增长率，但随着市场需求的逐步回升，标的公司将逐步加大核心产品的市场推广力度，高性能ESD保护器件、MOSFET器件、大功率模块产品以及高压大功率FRD等产品的销量将逐步显现，预期业绩承诺期内标的公司的在手订单将逐步提高；同时标的公司也将持续深化与重点客户的合作，特别是珠三角、长三角区域的目标客户，以获取增量订单，并转化为营业收入，提高标的公司营收规模。

标的公司为扩大业务规模制定了以下主要措施：1)深化现有核心客户合作：通过提升服务能力、强化品牌和优化客户关系，提升在核心客户中的份额；2)拓展新兴应用市场：积极布局新能源汽车、充电桩等高增长领域，凭借定制化解决方案和市场渗透策略发展业务；3)强化研发与产品迭代：持续加大研发投入，紧跟市场需求与技术趋势，系统推进产品更新与技术创新，不断提高竞争力。此外，本次重大资产购买完成后，标的公司将成为上市公司控股子公司。上市公司将整合其丰富的客户资源与渠道优势，对标的公司进行赋能，助其拓宽客户群体和收入来源，提升营收规模。双方在客户资源上具有协同潜力：上市公司可借助标的公司客户推广集成电路设计产品，标的公司则可利用上市公司销售网络拓展新市场。通过联合服务客户，双方不仅能扩大市场覆盖面、降低营销成本，还能提升客户满意度与忠诚度。

基于上述标的公司管理层预期，在手订单数量及金额预计将在业绩承诺期内逐步提高，支持标的公司营业收入及净利润增长。

(2) 产品线开发进展情况

标的公司重视研发及产品迭代，近年来拓展的产品线涵盖高性能 ESD 保护器件、MOSFET 器件、大功率模块产品、高压大功率 FRD 等在内的多项关键产品，展现了强劲的技术创新能力。以下具体说明标的公司拟重点拓展的产品线开发进展、预期量产时间，以及稳定期后预期年增量收入等情况：

产品类别	产品优势	主要应用领域	开发进展情况	预期量产时间	稳定期后预期年增量收入
高性能 ESD 保护器件系列产品	产品具有超低电容、低功耗、强浪涌电流泄放能力、响应速度快、可自行恢复等特点，综合技术水平处于国内领先地位	主要应用于高速数据传输端口保护，如笔记本电脑、手机、5G 基站设备、汽车高速总线等	目前已有多个型号产品通过客户验证，进入量产阶段；面向 6G 应用领域的 ESD 阵列产品（纵向结构低电容）工艺平台开发，进入工程批阶段	2025 年 12 月	3000 万/年
MOSFET 器件	SGTMOS 系列产品具有超低的导通电阻 RDS(on)；低功耗高压超结 MOS 产品通过交替的 P/N 柱电荷平衡技术大幅降低导通电阻，开关损耗低，高温特性优	主要应用于户用和工商业光伏逆变、户用和工商业储能、光储充电等市场	系产学研合作项目，首批样品经过检测达到设计要求，进入客户小批量使用阶段	2025 年 12 月	1000 万/年
低热阻、高压大电流、抗干扰可控硅器件	产品具有高断态电压、抗噪声性能、抗浪涌能力强、低热阻等特点	广泛应用于充电桩、UPS、智能控制、微逆变等领域	微逆变应用领域的抗干扰单向晶闸管系列、充电桩、UPS、智能控制应用领域的高压、大电流单向晶闸管、双向可控硅系列产品进入量产阶段	已具备量产条件	4000 万/年

产品类别	产品优势	主要应用领域	开发进展情况	预期量产时间	稳定期后预期年增量收入
			高压大电流、低热阻的 ITO-247、TG 系列产品进入试制阶段	2026 年 3 月	
功率模块系列产品	产品具有高耐压、大电流、低漏电、低热阻、低功耗、高机械强度、防潮性能优等特点	主要应用于需高涌流能力、高热循环性能和高结温能力的应用场景，例如不间断电源（UPS）、变频器等领域	高耐压、大电流、低漏电、低热阻、低功耗 T1、T2、P1 封装外形产品进入量产阶段	已具备量产条件	3500 万/年
			P2、T3 系列产品进入试制阶段	2026 年 5 月	
具有软恢复特性的高压大功率 FRD 系列器件	产品具有开关特性好、反向恢复时间短等特点	主要应用于开关电源、PWM 脉宽调制器、变频器等电子电路中	具有软恢复特性的 100A、1200V、FRD 芯片已通过多家客户认证，进入客户小批量使用阶段	2025 年 10 月	2500 万/年
			400V、650V 系列产品，处于客户验证阶段	2026 年 6 月	
IGBT 系列器件	作为融合 MOSFET 与双极性晶体管优势的复合型功率半导体器件，具有低饱和电压、高脉冲电流能力、开关速度快等特点	广泛应用于新能源汽车、工业控制、轨道交通、智能电网与储能、家电、不间断电源（UPS）等领域	样品通过品牌客户上机测试，进入工程批阶段	2026 年 3 月	2000 万/年

注：以上预期增量收入为标的公司预估数，不构成盈利预测。

随着上述核心产品线不断开发完成并逐步实现产品量产，标的公司预期将实现较多增量收入，以上表初步预估，随着重点拓展的核心产品不断实现量产，预期将为标的公司每年带来约 16,000 万元的增量收入。特别说明的是，其一，上表中产品线预期量产时间仅代表标的公司该产品具备量产条件，实际可为标的公司带来的增量收入是逐年体现的，即标的公司上述产品实现增量收入需要一定时间

的爬坡期，收入增长具有一定的不确定性；其二，上述产品线预计量产时间，系综合考量了标的公司当前研发进度、设备调试进程、供应链稳定性、工艺成熟度、质量验证状态及后期量产资源配置等情况作出的判断，实际开发进度和量产时间受上述多方面因素影响，具有一定的不确定性。待标的公司审计、评估工作完成后，上市公司将在重组报告书中对标的公司业绩承诺等重要事项进行审慎论证。

标的公司产品广泛应用于消费电子、工业、通讯安防和汽车电子等领域，其需求受全球宏观经济波动与行业景气度变化影响，呈现出一定程度的周期性波动。此种消费市场的周期特性会传导至上游半导体行业，使得该行业的发展与宏观经济及终端市场整体走势密切相关。2019年至2021年，受行业周期性波动影响，功率半导体产品的市场供给情况较为紧张，行业内公司整体处于快速扩产的阶段，受益于此标的公司业绩增长较快；2022年开始，行业整体处于产能消化以及去库存阶段，导致标的公司业绩较上年降幅较大；至2024年，上述行业调整逐步完成，标的公司业绩也有所增加，预期后续标的公司也将随着行业步入增长区间，逐步提高自身营业收入。

标的公司产品已渗透至消费电子、工业制造、安防监控、通信设备、汽车电子等传统与新兴领域。当前，5G通信、新能源产业、节能环保、智能电网建设、AR/VR等新兴产业的蓬勃发展，为功率半导体器件开辟了更广阔的应用空间。与此同时，随着国内微电子与半导体行业在工艺技术和产品质量上的持续提升，标的公司有望在替代进口产品的潜在市场中进一步占据市场份额。

(3) 销售毛利率

在毛利率方面，报告期内标的公司的毛利率分别为23.51%、21.90%和20.90%。基于标的公司管理层预期，未来三到五年毛利率预计将提高至26%-29%的范围。以下具体说明：

报告期内，标的公司的主要产品的毛利率情况如下：

产品类别	项目	2025年1-3月		2024年度		2023年度
		毛利率	变动	毛利率	变动	毛利率
功率半导体器件	晶闸管	13.56%	-4.70%	18.26%	0.43%	17.83%

产品类别	项目	2025年1-3月		2024年度		2023年度
		毛利率	变动	毛利率	变动	毛利率
	ESD 成品	23.34%	-0.61%	23.94%	2.87%	21.08%
	其他	9.95%	3.38%	6.57%	1.52%	5.05%
	小计	14.00%	-3.92%	17.92%	0.67%	17.25%
功率半导体芯片	保护器件芯片	37.22%	6.34%	30.88%	-6.17%	37.05%
	其他	30.71%	-2.17%	32.88%	-4.69%	37.58%
	小计	36.50%	5.48%	31.01%	-6.07%	37.08%
合计		20.90%	-0.99%	21.90%	-1.61%	23.51%

如上表所示，标的公司 2023 年、2024 年、2025 年 1-3 月的主营业务毛利率分别为 23.51%、21.90% 和 20.90%。2023 年至 2024 年，标的公司的营业收入规模有所增长，但毛利率存在小幅下降，主要原因系当期功率半导体芯片的毛利率受大客户上海维安半导体有限公司销售价格下调影响较大所致，该客户的采购规模较大，从长远合作角度考虑，标的公司在价格方面给予了一定下调，上述客户后续价格的恢复情况具有一定的不确定性。从整体收入变动角度来看，虽然标的公司 2024 年度营业收入较 2023 年度提高了 8.44%，但由于收入基数较低，上升的销售金额较为有限，规模效应改善不明显，毛利率受部分大客户售价的影响仍然较大；2025 年 1-3 月的主营业务毛利率较 2024 年有所下降，主要原因系 2025 年 1-3 月受春节假期的影响，整体产量相对较少，相应的单位分摊成本较高，导致晶闸管和 ESD 产品的毛利率均有所下滑，同时受铜价持续上涨的影响，主要原材料引线框架采购成本有所上升。铜作为大宗商品，其当前价格仍处于历史较高位置，从历史经验来看，铜价呈现一定的周期性波动趋势，标的公司业绩承诺期为四年，铜价的周期性波动可能对标的公司短期毛利率造成一定影响，但对于业绩承诺期内的累计业绩情况预计影响较小。

与同行业可比公司相比，标的公司的毛利率水平相对较低（同行业可比公司情况详见本题“一、结合报告期内标的公司的主要客户、供应商情况，产品结构、产销量、毛利率等情况，分析说明标的公司近年来经营业绩相较于 2021 年降幅较大的原因，与同行业可比公司是否存在差异，报告期内主要客户是否发生重大变化”之“（七）与同行业可比公司是否存在差异”），随着标的公司预期收入

的不断增长，标的公司毛利率上升空间较大。

关于未来三到五年的预期毛利率，随着收入规模的逐渐提升，功率半导体器件行业的规模效应也将逐步显现，单位产品分摊的折旧摊销、人工成本等固定成本费用有望相应降低；同时，标的公司也将进一步加大力度推广高性能 ESD 保护器件、MOSFET 器件、大功率模块产品以及高压大功率 FRD 等高毛利产品，提升高毛利产品在销售结构中的占比，进而从整体上改善标的公司毛利率水平。基于对标的公司经营情况的整体判断，标的公司业绩承诺期内毛利率有望在现有水平基础上提升至同行业可比公司平均水平。根据标的公司管理层预期，未来三到五年的毛利率预计将提高至 26%-29%的范围。毛利率测算系标的公司管理层基于对行业和标的公司经营情况的预估，尚需进一步论证，待标的公司审计、评估工作完成后，上市公司将在重组报告书中对标的公司业绩承诺等重要事项进行审慎论证并及时披露。

在净利率方面，业绩承诺期内标的公司分别以 9.5%、10.5%、11.5%和 12.5%作为净利率预测指标，主要系参考了 2023 年、2024 年的期间费用率、营业税金及附加等情况，并对后续变动进行一定预估所得。2023 年、2024 年，标的公司期间费用等项目占营业收入的比例具体如下：

项目	2023 年	2024 年
销售费用率	2.99%	2.61%
管理费用率	7.50%	6.67%
研发费用率	4.83%	5.35%
财务费用率	0.74%	0.93%
营业税金及附加	1.11%	0.72%
合计	17.17%	16.28%

如上表所示，2023 年、2024 年标的公司期间费用率、营业税金及附加等科目合计占营业收入的比例分别为 17.17%、16.28%，以 16.5%作为业绩承诺期内各项费用的预计占比（理论上随着收入规模增加，期间费用率应缓慢下降，此处按照 16.5%固定值测算具有谨慎性），按照毛利率 26%-29%计算，标的公司的净利率预计在 9.5%-12.5%范围内。

（4）资产折旧情况及减值风险

截至 2025 年 3 月 31 日，标的公司的固定资产情况如下：

单位：万元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率
房屋与建筑物	11,865.73	3,625.11	-	8,240.62	69.45%
机器设备	29,388.42	14,348.96	-	15,039.46	51.17%
运输设备	268.27	240.74	-	27.53	10.26%
办公及其他设备	477.27	331.92	-	145.35	30.45%
固定资产装修	816.43	418.66	-	397.77	48.72%
合计	42,816.12	18,965.39	-	23,850.73	55.71%

截至 2025 年 3 月 31 日，标的公司的无形资产情况如下：

单位：万元

项目	账面原值	累计摊销	减值准备	账面价值
土地使用权	1,710.65	176.41	-	1,534.24
软件	153.72	87.25	-	66.47
合计	1,864.37	263.66	-	1,600.71

在固定资产折旧与无形资产摊销方面，2023 年、2024 年和 2025 年 1-3 月，标的公司固定资产折旧额分别为 2,775.48 万元、2,904.12 万元和 777.09 万元，无形资产摊销额分别为 45.69 万元、46.88 万元和 11.74 万元。报告期内，标的公司每年折旧及摊销金额主要系机器设备、房屋与建筑物折旧，以及土地使用权摊销。标的公司销售规模稳中有升，生产线亦处于成熟状态，故整体资产折旧、摊销金额也较为稳定。

在减值风险方面，基于对标的公司资产使用状况的分析，其利用效率维持正常水平，未出现闲置情形，故未呈现显著减值迹象。同时，审视外部市场环境，标的公司相关资产的市场价格保持稳定，所属行业及整体市场亦未发生重大不利变动，企业整体经营态势稳健。以下进一步分析说明标的公司的产品工艺情况：

在产品工艺方面，标的公司目前拥有 4 英寸、5 英寸和在建的 6 英寸晶圆生产线，配套兼容 4 英寸、5 英寸、6 英寸和 8 英寸的芯片封装测试生产线，符合当前关于晶闸管、保护器件的生产需求。

针对晶闸管产品，目前市场上主流的生产线涵盖 4 英寸、5 英寸、6 英寸，一方面系出于成本角度考虑，另一方面，在光刻工艺方面，4 英寸、5 英寸、6 英寸可以实现可靠的双面光刻，而 8 英寸、12 英寸晶圆因双面光刻技术实现难度大且成本高昂，同时减薄后的晶圆在机械强度和工艺操作性上难以满足可靠、高效的双面加工要求，因此市场上目前基本不涉及 8 英寸、12 英寸的晶闸管生产线；在保护器件方面，TVS、TSS 的主流生产线仍为 4 英寸、5 英寸，主要是该类保护器件对特征尺寸（线宽）要求较低，基于经济性考量，无需使用成本更高的大尺寸晶圆生产线，ESD 产品主流生产线则为 6 英寸、8 英寸；MOSFET、IGBT 的主流生产线为 8 英寸、12 英寸，该产品对特征尺寸和工艺复杂度要求较高，因此需要具备更先进制程能力的生产线。标的公司的产品主要以晶闸管、保护器件为主，其当前采用的晶圆生产线尺寸与市场主流选择及产品工艺需求相匹配，能够有效满足当前生产需要，不存在被替代或淘汰风险。

关于标的公司产品线的技术改造，标的公司重视产品迭代，持续投入研发，相应的产品线技术改造也在持续进行，以适应下游行业不断提高的技术参数或其他方面的需求。2023 年、2024 年，标的公司固定资产折旧额分别为 2,775.48 万元、2,904.12 万元，2024 年较 2023 年标的公司折旧额上升了 4.63%。标的公司固定资产折旧和无形资产摊销的波动，按照使用部门分别计入成本和期间费用，体现在标的公司毛利率和期间费用率中，预计生产线常规技改不会对经营业绩产生重大不利影响。鉴于功率半导体器件行业的技术迭代较快，标的公司需要及时适应技术迭代或市场变化并作出相应调整，可能涉及新增产品线或相关设备等，进而影响业绩承诺期内的折旧情况，待标的公司审计、评估工作完成后，上市公司将在重组报告书中对标的公司相关情况进行审慎论证并及时披露。

3、业绩承诺期内收入、净利润等测算的合理性

(1) 标的公司作出的业绩承诺

2025 年 6 月 9 日，上市公司与标的公司、标的公司实际控制人李建新、李大威签署《关于江苏吉莱微电子股份有限公司之增资协议》，约定业绩承诺期累计承诺净利润不低于 15,000 万元，其中 2025 年度、2026 年度、2027 年度和 2028 年度，标的公司业绩目标分别为净利润 2,600 万元、3,300 万元，4,100 万元以及

5,000 万元。

上述各期承诺金额系标的公司以及业绩承诺方李建新、李大威，根据标的公司当前经营现状，结合管理团队对未来业务发展的判断，综合协商确定的，且李建新、李大威同意以现金方式或持有的标的公司股份作为业绩补偿措施。

（2）标的公司业绩承诺期内收入、利润测算的合理性

基于上述关于在手订单、毛利率、产品线开发进展等情况的分析，标的公司管理层对后续收入增长和毛利率提升具有较为良好的预期。特别说明的是，业绩承诺期内收入、毛利率、净利润等测算系标的公司管理层基于对行业和标的公司经营情况的预估，本次交易涉及的业绩承诺的合理性和可实现性仍需进一步论证，待标的公司审计、评估工作完成后，上市公司将在重组报告书中对标的公司业绩承诺等重要事项进行审慎论证并及时披露，提请投资者注意相关投资风险。

（二）结合标的公司历史业绩情况说明业绩承诺的可实现性

标的公司历史业绩及业绩承诺的可实现性详见本题“三、结合标的公司业务发展规划及业务开展情况，包括但不限于在手订单数量、金额、执行情况、销售毛利率、产品线开发进展、资产折旧情况及减值风险等，说明标的公司业绩承诺期内收入、净利润等测算依据、具体过程及其合理性，并结合标的公司历史业绩情况说明业绩承诺的可实现性”之“（一）标的公司业务发展规划、业务开展情况，以及业绩承诺期内收入、净利润等测算依据、具体过程及其合理性”。

为进一步保护上市公司中小股东利益，经上市公司与标的公司、标的公司实际控制人协商，标的公司设置了业绩承诺条款，标的公司实际控制人承担业绩补偿责任。业绩承诺期结束后，若标的公司累计实现的净利润未达到累计承诺净利润目标的 80%，则业绩承诺期届满后，业绩承诺方需对上市公司一次性进行业绩补偿。关于具体的补偿措施，上市公司可选择现金或股份补偿方式。

根据《关于江苏吉莱微电子股份有限公司之增资协议》，上市公司与业绩补偿方明确约定了业绩补偿的触发条件、补偿方式以及计算方式，同时双方也就业绩补偿事项约定了补偿上限。针对股份补偿方式，业绩补偿方的补偿上限为业绩承诺方届时直接以及通过威锋贸易间接合计持有的标的公司股份，且应优先转让

其直接持有的股份。针对现金补偿方式，补偿上限为 17,039.4107 万元（即业绩承诺方目前直接以及通过威锋贸易间接合计持有标的公司 3,348.5459 万股*本次增资价格，覆盖了业绩承诺期的合计承诺净利润 1.5 亿元）。综上，本次上市公司与业绩承诺方的业绩补偿约定，是以业绩承诺方直接及通过威锋贸易间接持有的全部股份为基础计算的，考虑了业绩承诺方的实际情况，业绩补偿具有较高的可实现性。

3、关于交易价格

预案显示，上市公司拟向吉莱微增资 2.2 亿元取得其 4323.35 万股股份，占增资后吉莱微总股本的 45.28%。2025 年 2 月 7 日，吉莱微召开股东会审议通过回购议案，拟向 6 名机构股东回购其所持吉莱微 1097.70 万股股份，占其增资前持股比例的 21.01%。

请公司补充披露：本次增资交易价格的确定方法、依据及测算过程，结合标的公司经营业绩及业绩承诺、向机构股东回购股份的价格及预计时间等，说明本次交易价格的公允性及合理性。请独立财务顾问发表意见。

【回复】

一、本次增资交易价格的确定方法、依据及测算过程、向机构股东的回购价格及预计时间等

本次交易价格初步拟定为 2.2 亿元人民币，即上市公司拟向标的公司增资 2.2 亿元人民币，取得标的公司 4,323.3494 万股股份，占标的公司本次增资完成（同时假设其他机构股东回购减资完成）后股份比例的 51.1628%。

本次增资交易价格的确定方法、依据，系综合考虑标的公司其他机构股东回购事项、回购金额，以及回购完成后标的公司的账面净资产，由上市公司与标的公司根据市场化原则协商确定的。在标的公司评估方面，评估机构预计将使用资产基础法、收益法对标的公司进行评估，上市公司与标的公司将在审计、评估工作完成后签署补充协议，对本次增资交易价格进行确认。特别说明的是，标的公司后续需要向其他机构股东支付的股份回购款项，已根据会计准则要求，在本次交易完成前充分计提，未来标的公司向其他机构股东支付回购款项，不会影响标的公司未来净资产金额。

具体说明如下：

（一）标的公司股份回购事项

苏州同创同运同享科技创业投资合伙企业（有限合伙）、南京扬子区块链股权投资合伙企业（有限合伙）、上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙）、

漳州漳龙润信科技产业投资合伙企业（有限合伙）、启东金北翼母基金投资合伙企业（有限合伙）、无锡金灵医养创业投资合伙企业（有限合伙）（合称“其他机构股东”），系标的公司除控股股东及其一致行动人外的全部机构股东，且均为经中国证券投资基金业协会备案的私募投资基金，合计持有标的公司 21.01% 的股份。

2025 年 2 月 7 日，吉莱微召开 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司回购部分股东所持公司股份的议案》，议案主要内容如下：经各方协商，吉莱微全体股东同意回购其他机构股东所持有的吉莱微全部股权，回购价格参照该等股东的出资款本金由吉莱微及其控股股东、实际控制人与相关股东协商确定。

根据其他机构股东与吉莱微另行签署的股份回购协议，回购价格为其他机构股东的出资款本金，结合具体投资时间、回购款项预计支付时间，按照年化 5% 利息支付给相应股东（六家其他机构股东的回购总额均根据出资时间、回购款项支付时间，按照年化 5% 的回报按日计息确定）。标的公司其他机构股东均为私募投资基金，目前的回购价款系标的公司与其他机构股东友好协商后确定，该利率约定属于合理区间范围内。

在股份回购款项的支付时间方面，基于前期标的公司与其他机构股东签署的按照 5% 利率回购的协议，吉莱微将在 2025 年至 2029 年期间，通过分期付款的方式向其他机构股东支付回购款项。

标的公司股份回购事项与上市公司本次增资事项相互独立，上市公司在与标的公司接洽之前，标的公司已经明确了其股份回购事项。鉴于本次上市公司拟通过现金方式增资标的公司，增资后标的公司资金较为充裕。标的公司有意向与其他机构股东就回购条款进行协商，在其他机构股东愿意降低回购利率的前提下，标的公司可以考虑一次性支付股份回购款项。对于标的公司而言，回购利率下降，需要支付的回购款项总额下降，标的公司可将更多的资金用于发展自身业务；对于其他机构股东而言，其可以一次性获得股份回购款项，与前期 4-5 年分期支付相比，可以减少不确定性。

标的公司其他机构股东出资情况，以及回购款项（基于前期标的公司与其他

机构股东签署的按照 5%利率回购的协议) 等信息具体如下:

单位：万元

序号	股东	出资总额 (万元)	出资时间	投资估值 (万元)	计入股本 (股)	占比	回购款项 总额	回购整体估 值	截至 2025- 3-31 已支 付金额	回购款项 对应的年 化利率
1	上海祥禾涌原股权投资 合伙企业（有限合伙）	4,500.00	2021年6月	101,999.18	2,304,942	4.4118%	5,689.35	120,707.23	900.00	5%
2	南京扬子区块链股权投 资合伙企业（有限合 伙）	2,000.00	2020年11 月	44,679.76	2,338,675	4.4763%	2,583.73	53,932.82	352.94	
3	苏州同创同运同享科技 创业投资合伙企业（有 限合伙）	3,000.00	2021年2月	62,899.68	2,491,829	4.7695%	5,736.21	85,974.81	794.12	
		1,500.00	2021年6月	101,999.18	768,314	1.4706%				
4	无锡金灵医养创业投资 合伙企业（有限合伙）	1,000.00	2021年6月	101,999.18	512,209	0.9804%	1,265.83	120,816.99	176.47	
5	漳州漳龙润信科技产业 投资合伙企业（有限合 伙）	3,000.00	2021年6月	101,999.18	1,536,628	2.9412%	3,788.39	120,547.90	-	
6	启东金北翼母基金投资 合伙企业（有限合伙）	2,000.00	2021年6月	101,999.18	1,024,419	1.9608%	2,536.33	121,023.38	-	
合计		17,000.00	-	80,911.54	10,977,016	21.0106%	21,599.84	96,177.84	2,223.53	-

注：回购整体估值系根据分期支付安排下的回购款项现值除以股份比例所得。

（二）标的公司主要财务指标

2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-3 月，标的资产未经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2025. 3. 31/2025 年 1-3 月	2024. 12. 31/2024 年度	2023. 12. 31/2023 年度
总资产	62,397.22	64,605.74	56,807.52
总负债	40,872.04	23,281.01	17,042.87
净资产	21,525.18	41,324.72	39,764.64
营业收入	4,921.85	25,619.38	23,625.95
净利润	403.92	1,560.08	1,395.60

如上表所示，截至 2024 年 12 月 31 日，标的公司净资产为 41,324.72 万元，截至 2025 年 3 月 31 日，标的公司净资产为 21,525.18 万元。2025 年 3 月末标的公司净资产较 2024 年末下降较多，主要系该金额已经考虑并计提后续需要支付给标的公司其他机构股东的股份回购款。

综上，本次增资交易价格，系综合考虑了标的公司账面净资产、标的公司机构股东回购事项、回购金额后，由交易双方根据市场化原则协商确定的。

二、本次交易价格的公允性及合理性

本次增资价格，系上市公司、标的公司综合考虑了标的公司机构股东回购事项、标的公司整体净资产规模后协商确定的。标的公司经营业绩及业绩承诺详见本回复“2、关于标的公司业绩承诺”的相关内容。

本次增资交易价格初步拟定为 2.2 亿元人民币，假设标的公司其他机构股东完成减资，上市公司以 2.2 亿元人民币取得的标的公司股份，占标的公司总股本的 51.1628%，对应的投后估值为 4.30 亿元人民币。根据标的公司 2025 年 3 月末的账面净资产 21,525.18 万元，以及上市公司拟投入的 2.2 亿元增资款，本次交易完成后，标的公司的净资产约为 43,525.18 万元（未经审计），与本次上市公司的投后估值基本持平。按照市净率测算，本次增资的市净率低于 1 倍。

按照市盈率测算，本次增资的投前估值为 2.1 亿元，按照标的公司 2024 年

度未经审计的净利润初步预估，本次交易的市盈率为 13.46 倍；按照业绩承诺期内的平均承诺净利润 3,750 万元（即 15,000 万元/4 年=3,750 万元/年）预估，本次交易的市盈率为 5.6 倍。

与标的公司其他机构股东投资估值及回购估值相比，本次上市公司增资交易价格对应的整体估值较低，不存在以不合理的高估值收购标的公司导致上市公司中小股东利益受损的情形。

综上，上市公司本次增资交易价格综合考虑了标的公司机构股东回购事项、标的公司整体净资产规模，投后估值与标的公司的账面净资产基本持平；同时，本次增资交易约定了业绩承诺，如果标的公司触发业绩承诺要求，标的公司原实际控制人作为业绩承诺方，需对上市公司进行业绩补偿。总体而言，本次交易价格具有公允性和合理性，不存在损害上市公司中小股东利益的情形。

上述楷体加粗部分已在本次交易预案“第五节 交易标的估值情况”中补充披露。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司董事会

二零二五年七月二十四日